



中微半导体pack包安装使用说明

Rev. 1.0

请注意以下有关CMS知识产权政策

* 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称本公司）已申请了专利，享有绝对的合法权益。与本公司MCU或其他产品有关的专利权并未被同意授权使用，任何经由不当手段侵害本公司专利权的公司、组织或个人，本公司将采取一切可能的法律行动，遏止侵权者不当的侵权行为，并追讨本公司因侵权行为所受的损失、或侵权者所得的不法利益。

* 中微半导体（深圳）股份有限公司的名称和标识都是本公司的注册商标。

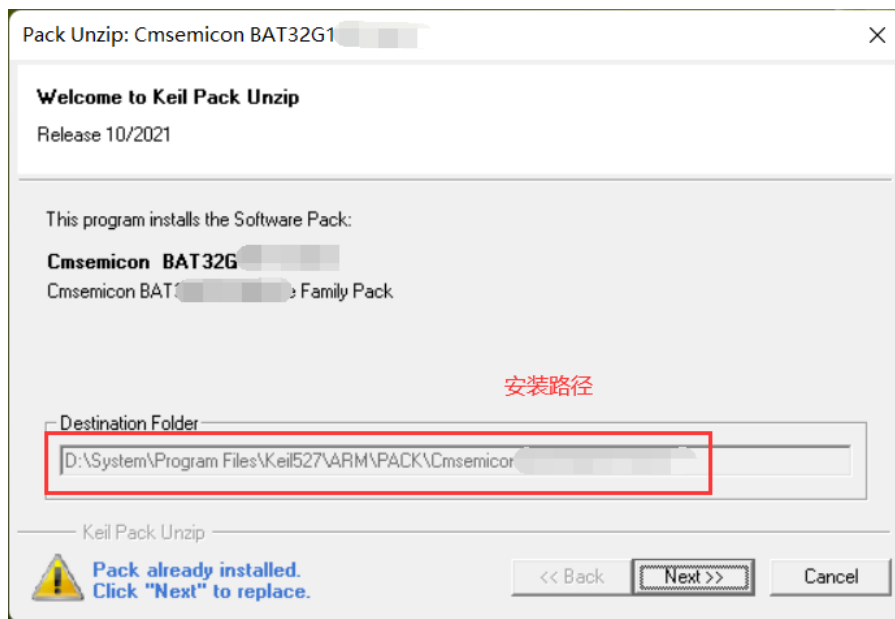
* 本公司保留对规格书中产品在可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。然而本公司对于规格内容的使用不负责任。文中提到的应用其目的仅仅是用来做说明，本公司不保证和不表示这些应用没有更深入的修改就能适用，也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。本公司的产品不授权适用于救生、维生器件或系统中作为关键器件。本公司拥有不事先通知而修改产品的权利，对于最新的信息，请参考官方网站 www.mcu.com.cn。

1 前言

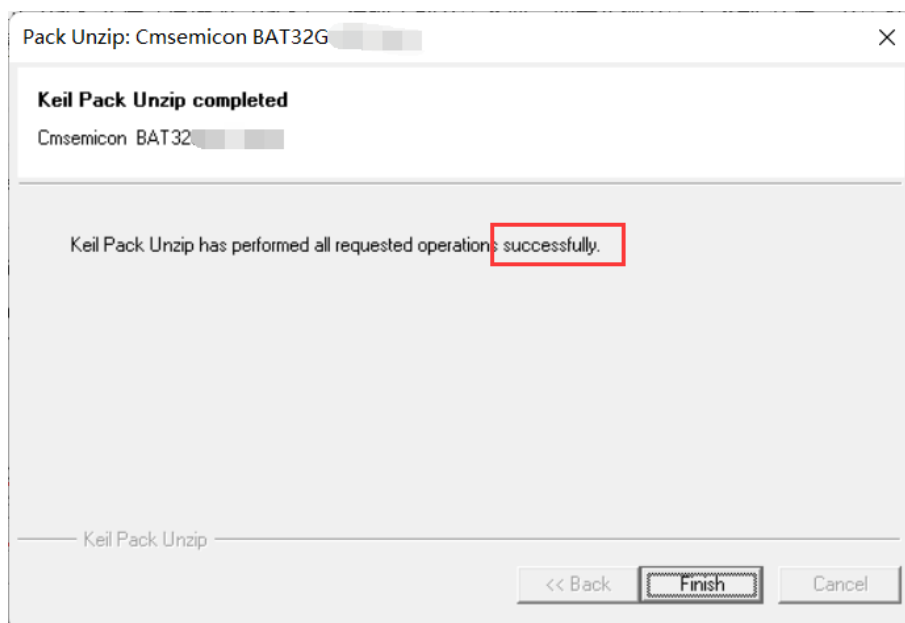
中微半导体 pack 包内包含了常用外设的参考例程（DemoCode），本文档简单介绍了 pack 包的安装步骤及例程的获取路径。

2 安装步骤

- 1、双击 pack 文件（后缀为*.pack），在弹出的安装界面，如果正确安装了 Keil 软件，安装程序会自动选择安装路径，pack 包内相关文件会解压到此路径下。

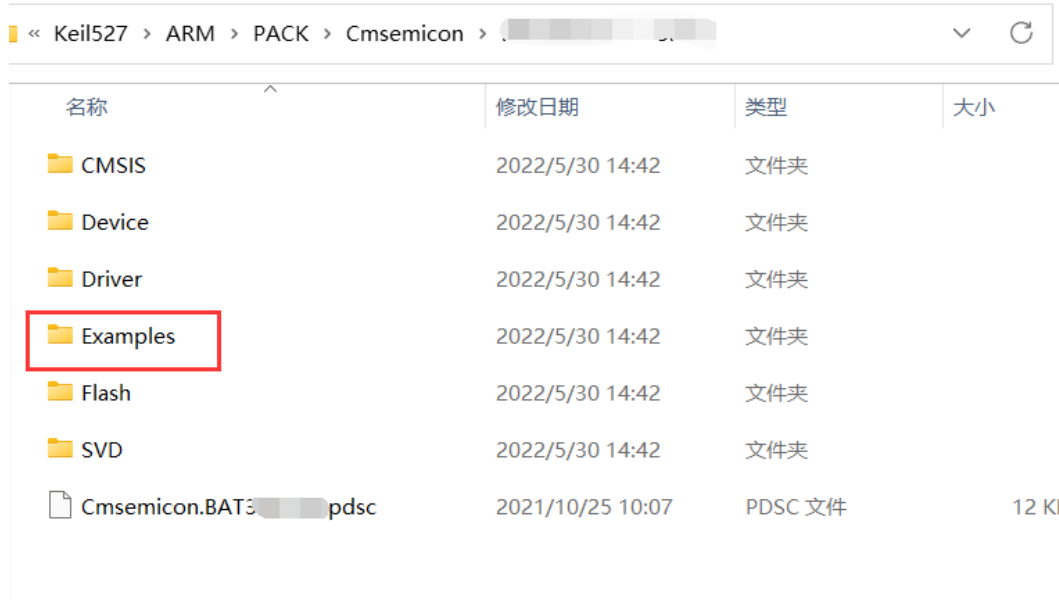


- 2、点击“Next”菜单，如果显示下图安装成功的信息，点击“Finish”完成安装。



3 例程获取

- 1、找到安装步骤 1 的路径，在该目录下有 CMSIS, Device, Driver, Examples 等文件夹，其中 **Examples** 文件夹下为参考例程 (DemoCode)，例程对 Driver 等文件夹下的文件也有调用，建议可以将下图中的**所有**文件都复制到一个文件夹中。



- 2、由于 pack 包内的文件都是只读的，复制完文件后，请将所有文件的“只读”属性去除，去掉只读属性后，代码才可以正常编辑。



更改记录

版本	记录	日期
V1.0	初版。	2022年5月